

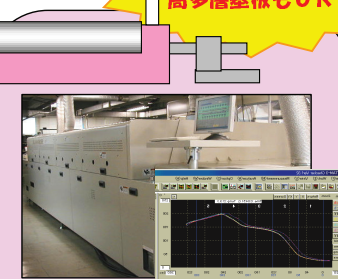
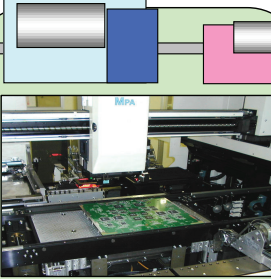
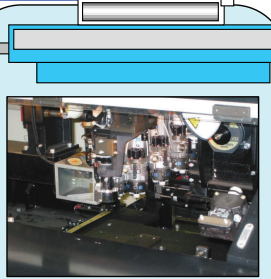
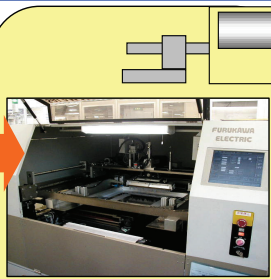
基板実装工程の紹介

基板サイズ: 510×450まで対応
 高多層、高密度実装もOK
 チップサイズ: 1005まで対応可能
 BGA、CSPも お任せください!!

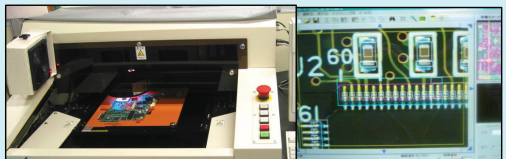
株式会社OA研究所 製造グループ

N2対応
 11ゾーンリフロー
 高多層基板もOK

生産
 スタート



部品搭載 (実装有無)
 極性、スレ
 はんだフィレットの
 有無を検査できます。



段取り、セッティング

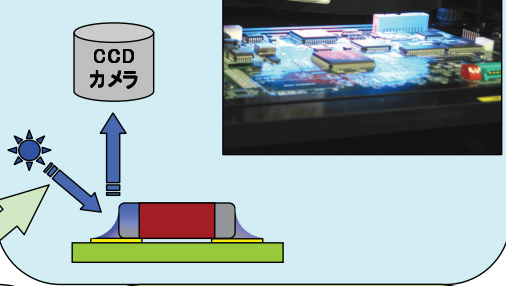
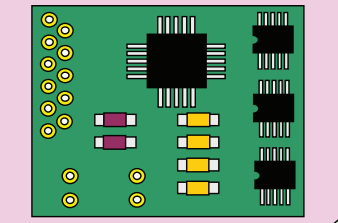
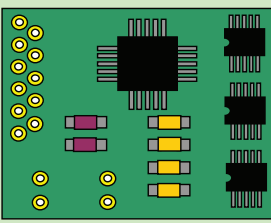
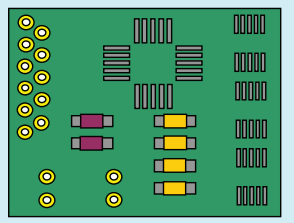
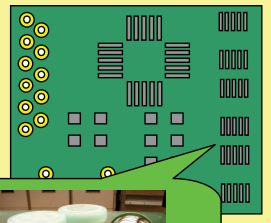
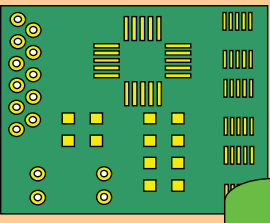
クリームはんだ印刷

チップ部品搭載

QFP、BGA搭載

リフローはんだ付け

AOI搭載検査

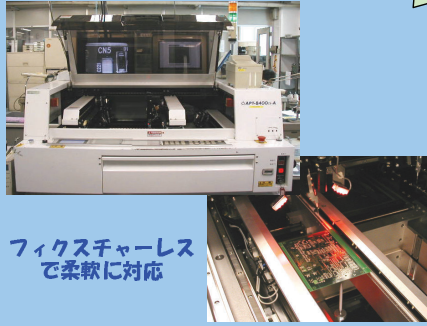
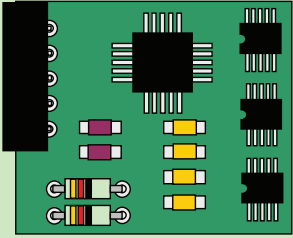
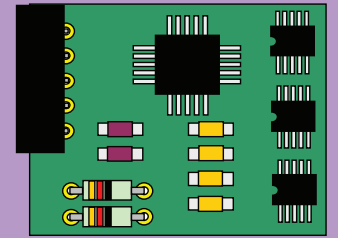


Pbフリーも対応可能!

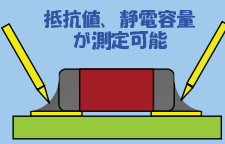
部品取付け

はんだ付け

ICT検査



フィクチャーレス
 で柔軟に対応



抵抗値、静電容量
 が測定可能

顕微鏡、目視検査



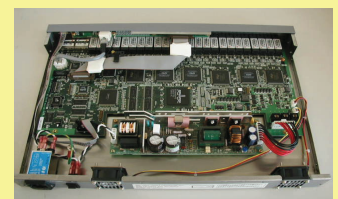
検査記録は
 10年間保管

図面との照合検査

次工程・出荷



基板単体での納入



ユニットへの組み込み

改修作業も可能です

はんだ付けは製品にあわせ
 ①フローはんだ
 ②ポイントソルダー
 ③手はんだ付け
 で対応します。

Check